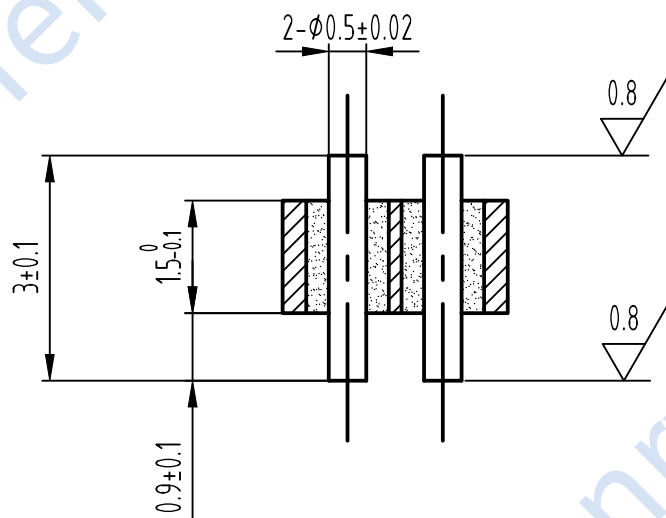
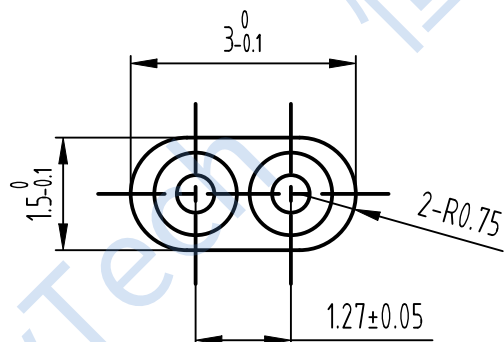




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65^\circ\text{C} \sim +155^\circ\text{C}$
6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP2-0.5-1.27(3-0.9)M

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						图样标记			重量		比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期							10:1	
设计	M。		标准化									
审核												
工艺			日期			共	页		第	页		